

放熱・硫化対策

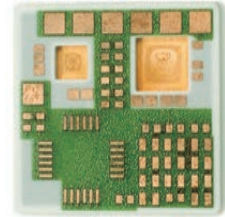
Heat Dissipation / Sulfidation Resistance to Substrates

放熱対策 Heat Dissipation

ヒートシンク付き積層基板 *Laminated Substrate with Metal*

- ✓ 金属ヒートシンク+積層基板
Metal Heat Sink + Laminated Substrate
- ✓ 熱伝導率 170W/(m·K)(金属ベース)
Thermal Conductivity 170W/(m·K) (Metal Base)
- ✓ 積層+厚膜回路によるコンパクト化
Downsizing by Laminated Substrate + Thick Film Circuit

共同開発: 日本特殊陶業株式会社様



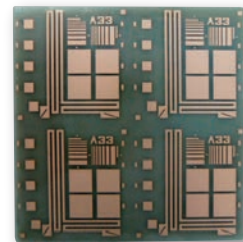
窒化ケイ素基板 *Metalized Silicon Nitride Substrate*

- ✓ 窒化ケイ素+銅導体(厚付:150 μ m)
Silicon Nitride + Copper Conductor (T: 150 μ m)
- ✓ 高温、大電流対応(50A以上)
High Temperature, High Current Corresponding (50A or more)
- ✓ 耐熱サイクル性(-40 $^{\circ}$ C \leftrightarrow 250 $^{\circ}$ C 3000サイクル)
Heat Cycle Resistance (-40 $^{\circ}$ C \rightarrow 250 $^{\circ}$ C, 3000 cycles)



窒化アルミ基板 *Metalized Aluminum Nitride Substrate*

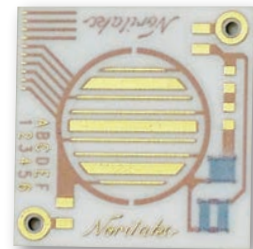
- ✓ 窒化アルミ+銅導体回路形成
Aluminum Nitride + Copper Conductor Circuit Formation
- ✓ 熱伝導率 170~200W/(m·K)
Thermal Conductivity of 170 - 200W/(m·K)
- ✓ 印刷による回路形成
Circuit Formed by Printing



硫化対策 Sulfidation Resistance

新銅導体+メッキ基板 *Developed Cu Conductor & Au Plating*

- ✓ 無鉛銅導体の新規開発
Development of New Lead-free Copper Conductor
- ✓ 無電解金メッキ対応
Electroless Gold Plating Correspondence
- ✓ 厚膜抵抗体の形成可能
Thick-film Resistor Formation Available



Contact us <http://www.noritake.co.jp/products/ceramic/ceramic/>

株式会社ノリタケカンパニーリミテド

セラミックス事業部 営業部 〒451-8501 名古屋市西区則武新町三丁目1番36号

E-mail: thickfilm@n.noritake.co.jp

TEL: (052) 561-9868

FAX (052) 561-7257